

2019年10月3日

各位

兼松米国会社

兼松フューチャーテックソリューションズ株式会社

**兼松、ブロックチェーン分野に進出**  
**～米国フィラメント社とアジアパシフィック市場における代理店契約締結～**

兼松米国会社（以下「兼松」）は、米国ネバダ州に拠点を持つ SWFL Inc.（以下「フィラメント社」）との間で、日本を含むアジアパシフィック市場における代理店契約を締結致しました。本契約により、日本ではエレクトロニクス技術商社の兼松フューチャーテックソリューションズ株式会社、アジアパシフィック市場では兼松株式会社の海外ネットワークを通して、フィラメント社のブロックチェーン製品(Blocklet™ Mobility Platform)を展開して参ります。

フィラメント社は特に変化の著しい自動車市場を中心とした、IIoT 市場(Industrial Internet of Things)にエンタープライズレベルのセキュリティを付与するブロックチェーンソリューションを提供致します。同社の Blocklet™製品は、ハードウェアとソフトウェアで構成されており、ハードウェアで生成される HSM(Hardware Security Module)とソフトウェアの組合せで行われる認証により、ブロックチェーン分野においてエンタープライズレベルのセキュリティ付与が可能になります。Blocklet™ ハードウェア製品は IC/USB/UART 等の複数の商品ラインナップを用意し、お客様のニーズに合わせてのソリューション提供が可能です。また同社製品は GDPR (General Data Protection Regulation), CCPA (California Consumer Privacy Act)に適合しております。フィラメント社の独自技術により、データをハードウェア/ソフトウェア両面から暗号化し、安全かつ強固なデータ保存・管理・消去が可能になります。

兼松とフィラメント社は、日本・アジアパシフィック市場において、より安全なブロックチェーンの普及・構築を目指してまいります。

<フィラメント社の概要>

会社名 : SWFL Inc.  
設立 : 2014 年  
CEO : Allison Clift-Jennings  
所在地 : 米国ネバダ州リノ  
事業内容 : IIoT 市場向けエンタープライズブロックチェーンの提供  
URL : <https://filament.com/>

以 上